

R & D

Research & Development

Each company of the "Sumitomo Electric Group" combines its unsurpassed creativity with knowledge and experience to generate ideas that allows the group to contribute to society.

住友電気工業株式会社

• 大阪製作所

〒554-0024 大阪市此花区島屋1-1-3
TEL (06) 6466-5651 (代) FAX (06) 6463-7229
サイバーセキュリティ研究開発室、電力ケーブル開発推進室、
パワーシステム研究開発センター、情報ネットワーク研究開発センター、
IoT研究開発センター、解析技術研究センター、新領域技術研究所、
エネルギー・電子材料研究所、伝送デバイス研究所、
パワーデバイス開発部、研究企画業務部

• 伊丹製作所

〒664-0016 兵庫県伊丹市昆陽北1-1-1
TEL (072) 772-3300 (代) FAX (072) 772-2525
解析技術研究センター、アドバンスドマテリアル研究所、伝送デバイス研究所、
パワーデバイス開発部、研究企画業務部、エネルギー・電子材料研究所

• 本社(大阪)

〒541-0041 大阪市中央区北浜4-5-33(住友ビル)
TEL (06) 6220-4141 (代)

• 横浜製作所

〒244-8588 横浜市栄区田谷町1
TEL (045) 853-7182 (代) FAX (045) 852-0597
解析技術研究センター、光通信研究所、
伝送デバイス研究所、研究企画業務部、
パワーシステム研究開発センター、
情報ネットワーク研究開発センター、新領域技術研究所

• 本社(東京)

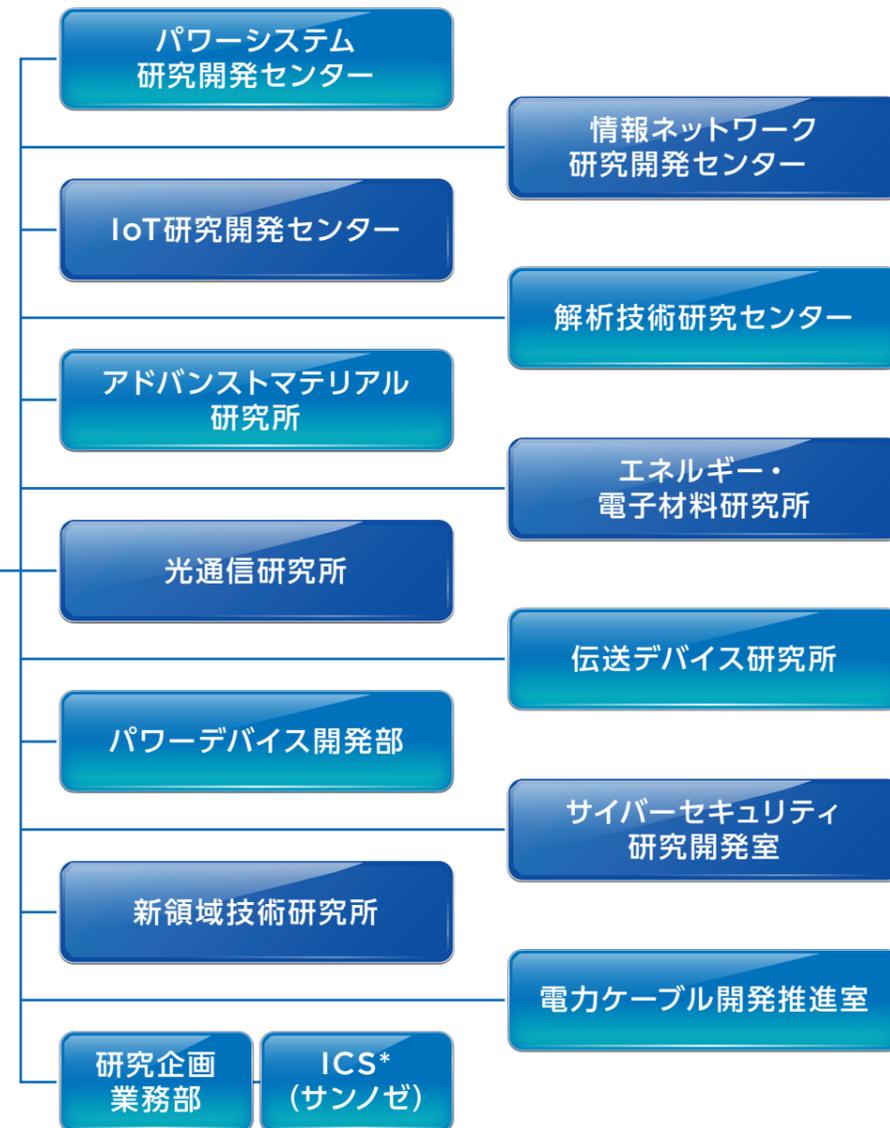
〒107-8468 東京都港区元赤坂1-3-13(赤坂センタービルディング)
TEL (03) 6406-2600 (代)
研究企画業務部

<https://sei.co.jp/>

中期経営計画“22VISION”と研究開発の取り組み

自動車の大変革、再生エネルギーの普及、ビッグデータの活用等、さまざまな変革に伴い、多くの新たな社会ニーズが生まれています。私たちは、『モビリティ』、『エネルギー』、『コミュニケーション』及びこれらを支える製品・サービス群における事業の成長を目指すとともに、事業・技術の多様性を活かしてイノベーションを創出し、よりよい社会の実現に貢献します。

研究開発本部



*ICS: INNOVATION CORE SEI, Inc.

Innovation Core SEI, Inc. (ICS)

2355 Zanker Road, San Jose, CA 95131, U.S.A
TEL : +1-408-232-9511



サンノゼオフィスビル

住友電工グループ初のR&D海外拠点として米国シリコンバレーに設立されたICSは、世界最先端の情報が集積する地の利を生かして、自動車・環境エネルギー・情報通信等の各分野における次世代技術・市場の調査・研究・融合領域における新規事業の創出に取り組んでいます。各開発センター、研究所と連携し、プロジェクトを推進しているほか、R&D部門のグローバル展開に向けたオープンイノベーションにも力を入れており、海外インターシッピング等の活動支援も行っています。

自動車分野

- コネクテッドカー・自動運転技術の調査、実証実験への参画
- EVを含む省エネ次世代自動車インフラの研究開発
- 革新する将来のモビリティのトレンド調査・分析



環境エネルギー分野

- 次世代エネルギー事業の柱となるRF電池・CPVの事業化
- 電力と情報通信の融合領域における新規事業の創出
- 当社材料技術の環境エネルギー分野への応用開拓



米国に導入したレドックスフロー電池

情報通信分野

- クラウドネットワークの進化に応じた技術トレンドの調査
- 通信技術の高度化を支える製品技術の提案
- IoT・インダストリー4.0がもたらす新しいビジネスの創出



中国解析センター / China Analysis Technology Center

江蘇省蘇州市蘇州新区金楓路 232 號
TEL : +86-512-6665-3090



中国解析センターが拠点を置く

Sumitomo Electric Interconnect Products (Suzhou) Ltd. (SESZ) の建屋

中国解析センターは、中国華東地区の蘇州市に拠点を置き、住友電工グループの中国における生産および開発活動を、分析・解析面から支援しています。

パワーシステム研究開発センター

電力インフラ分野の技術変革(再生可能エネルギー活用拡大、情報通信技術を用いた電力インフラの高度化)に対応した新技術、新製品を開発しています。具体的には、スマートグリッド(次世代電力網)の構築に必要な要素技術・製品・機器・システムの研究開発を推進しています。

レドックスフロー電池



再生可能エネルギー発電を利用する電力システムでは、その発電量の変動に応じて電力を貯蔵・放出する蓄電池の役割が特に重要になります。レドックスフロー電池は、不規則で変動の激しい充放電運転に適し、貯蔵電力量の正確な監視・制御が可能なることから、

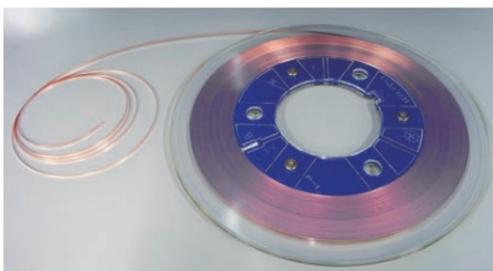
太陽光や風力などの再生可能エネルギーの有効活用を目指すスマートグリッドに最適な蓄電池と考えています。市場投入実績を持つレドックスフロー電池について、本格的な実用化を目指し、製品開発を進めています。

電力制御システム

太陽光発電等の再生可能エネルギー、蓄電池を最適制御して電力システムとの連系運転、または、電力システムと独立した自立運転を行うための電力変換装置であるパワーコンディショナをパワーエレクトロニクス技術を用いて開発しています。また、開発したパワーコンディショナを太陽光発電パネルや蓄電池と組み合わせた、住宅用および産業用の分散型電力システムも開発しています。



薄膜超電導線



世界で初めて開発した低コスト低磁性高強度配向金属基板上に高温超電導薄膜を形成しました。-196℃の液体窒素温度において、200A以上の電流を流すことができます(線材サイズ:幅4mm、厚さ150μm)。超電導ケーブルや超電導電磁石、NMR(核磁気共鳴)装置、MRI(磁気共鳴画像)装置等への応用が期待されています。

集光型太陽光発電装置

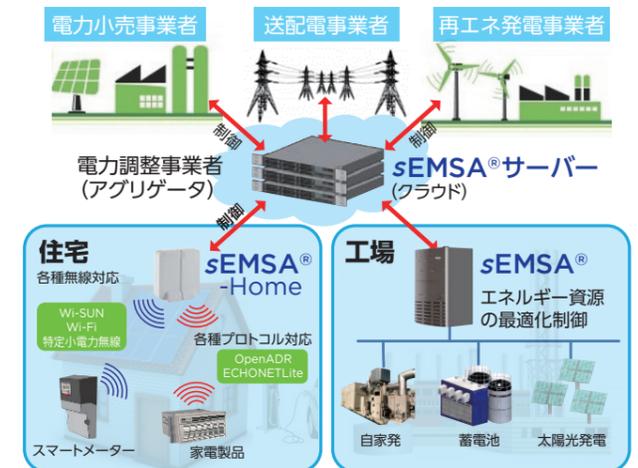


集光型太陽光発電装置(CPV)は、発電素子に特殊な化合物半導体材料を用いていることから、発電効率が市販のシリコンパネルに比べて約2倍であり、また集光パネルを地面から高い位置に設置する構造であり、パネル下のスペースも活用できるなど、次世代の太陽光発電装置として期待されています。当社が開発したCPVでは、従来のCPVに比べ、パネルの薄型化・軽量化を実現しています。

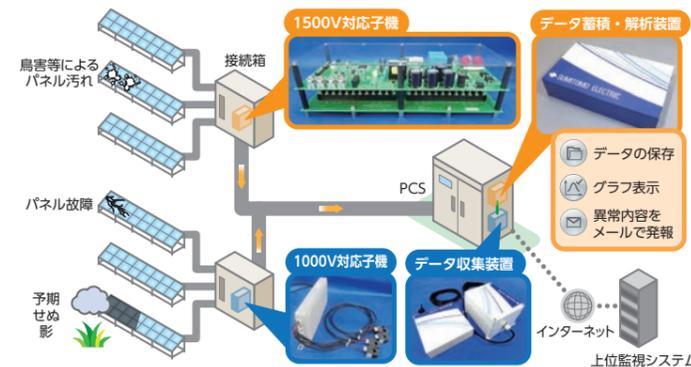
新エネルギーシステム

新エネルギーシステム・アーキテクチャ(sEMSA®)により、普及の進む太陽光発電やコジェネ、蓄電池などの分散電源を最適制御し、電力コスト低減を実現します。また、アグリゲータ向けに需要家を束ねてエネルギー資源を一元管理し、デマンドレスポンスなどで需要電力を調整することで、電力システムの安定化を図り、対価を得るシステムを構築することができます。

*Wi-SUNは、Wi-SUN Alliance, Inc. の商標または登録商標です。
*Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
*ECHONET、ECHONET Liteは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの商標または登録商標です。



電力応用システム



電力線通信(PLC)を応用し、スマートメータ用通信モジュールやメガソーラー用ストリング監視システムなどの開発を行っています。ストリング監視システムは、発電電力を測定するための電流や電圧センサーによるセンシング部、およびセンサーデータを伝送するPLC通信部を備えています。電力線を活用することで、新たな通信線や装置に必要な電源線の布設が不要となり、低コストで信頼性の高いシステムが構築できます。今後もPLC、無線通信技術やセンサを応用したIoTとともにAI等を活用した電力設備監視システムの開発を進めます。

情報ネットワーク研究開発センター

高速ブロードバンド通信を支える光ネットワークシステムと第5世代移動通信システム(5G)の無線通信技術を研究開発しています。また、モビリティ分野の取り組みとして、当社の無線技術を活用したインフラ用ミリ波レーダの開発や、車両プローブ情報を使った次世代交通システムやMaaS(Mobility as a Service)向け配車計画システムの研究開発を行っています。

光ネットワークシステム

年々増加するブロードバンド需要とIoTや5G無線、自動運転などの新しいサービスを支えるための研究開発を進めています。現行サービスより10倍高速なFiber to the Homeサービスを実現する10G-EPON*装置とその光部品、および低伝送遅延かつ高信頼なサービスを実現するイーサネットアクセス装置の開発に取り組んでいます。

*10G-EPON:10 Gigabit Ethernet Passive Optical Network

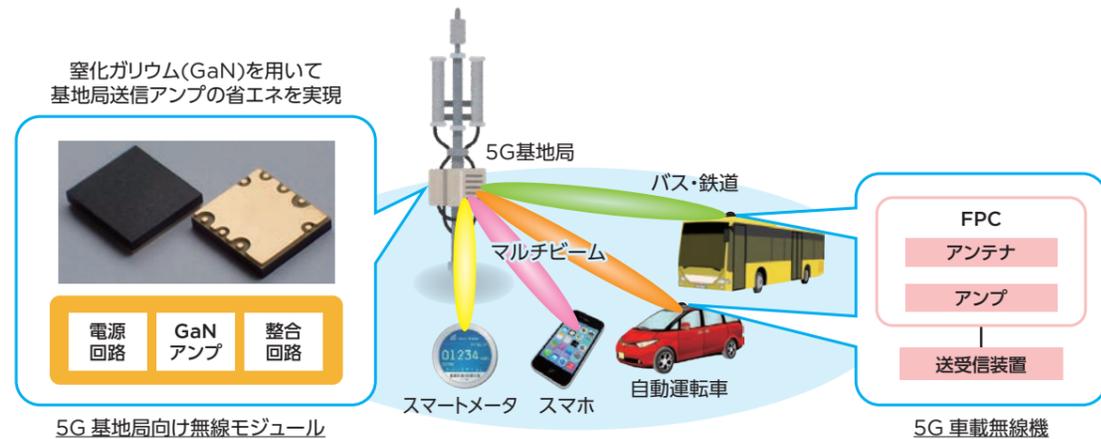


5G無線システム

2020年に導入が見込まれる第5世代移動通信システム(5G)は、超高速・低遅延・高信頼性・超多数接続を特長として、従来のスマートフォンだけではなく、全てのものが繋がるIoT*の世界を実現します。

*IoT:Internet of Things

当センターが所有する高周波増幅器の高効率化技術、アンテナ技術、および信号処理技術を基礎として、5G無線のインフラ市場やコネクテッドカー市場を対象に、無線機器や無線モジュールの開発に取り組んでいます。

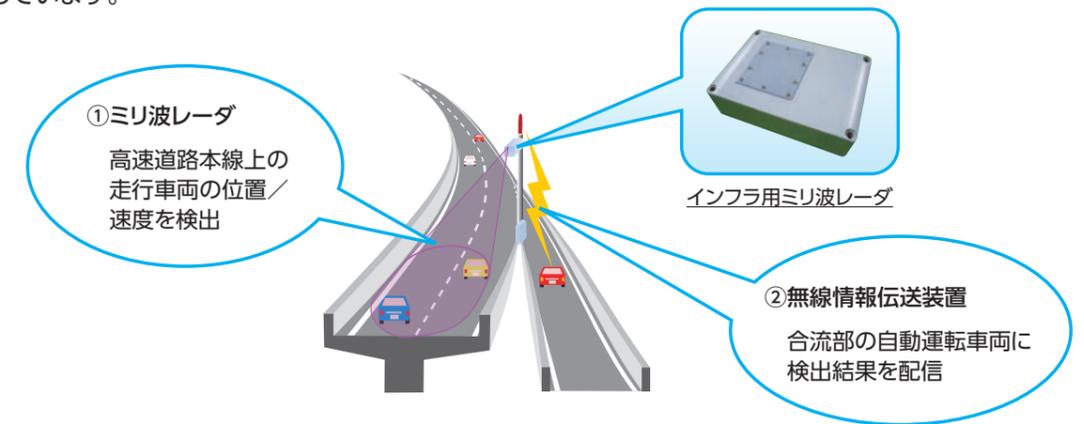


モビリティシステム

自動運転支援向けインフラ用ミリ波レーダ

近年、急速に実用化に向けた開発が進められている自動運転を実現するためには、高性能なセンサが不可欠で、ミリ波レーダのニーズが高まっています。

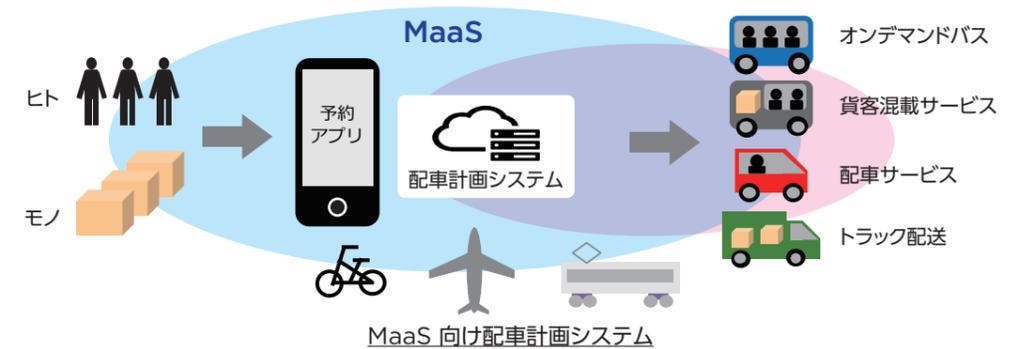
当センターでは、これまで培った無線技術を活用して交通インフラ市場向けに、走行車両の位置と速度を検出して車両に情報提供するインフラ用ミリ波レーダ装置の開発を行っており、安全・安心・快適な社会実現への貢献を目指しています。



次世代交通システム / MaaS 向け配車計画システム

安全・安心で地球環境に優しい交通社会の実現を目指し、次世代交通システム / MaaS向け配車計画システムの開発を進めています。

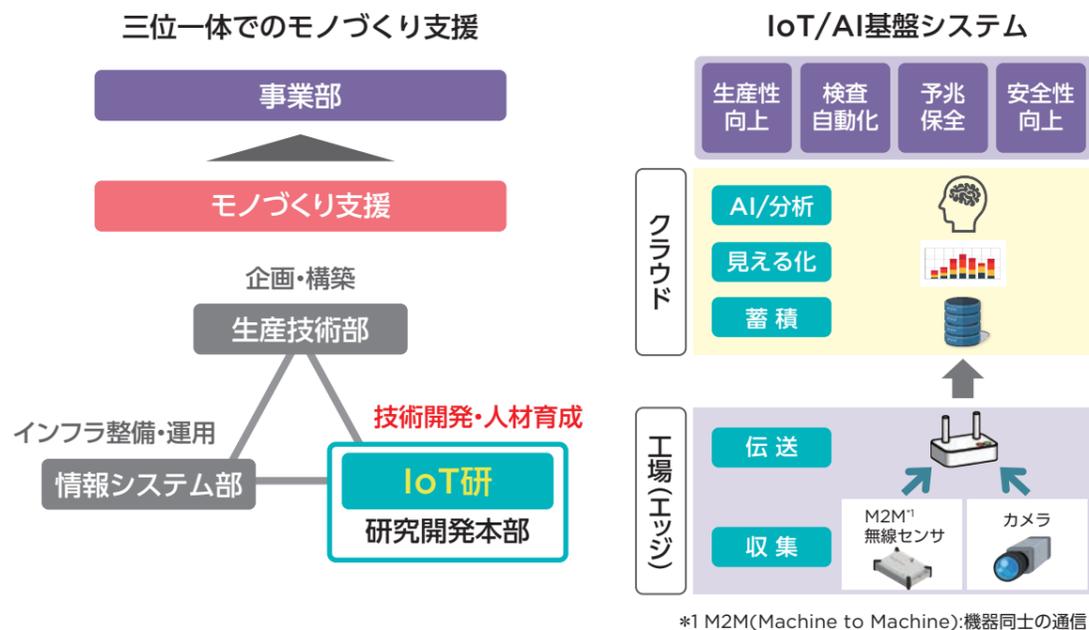
車の位置・速度などのプローブ情報をAIで処理し、信号制御や自動運転車向けに数キロ先までの動的に変化する車線別交通情報の提供を行うシステム、さらに、動態管理・配送計画技術を活用したMaaS向け配車計画システムの研究開発を行っています。



IoT研究開発センター

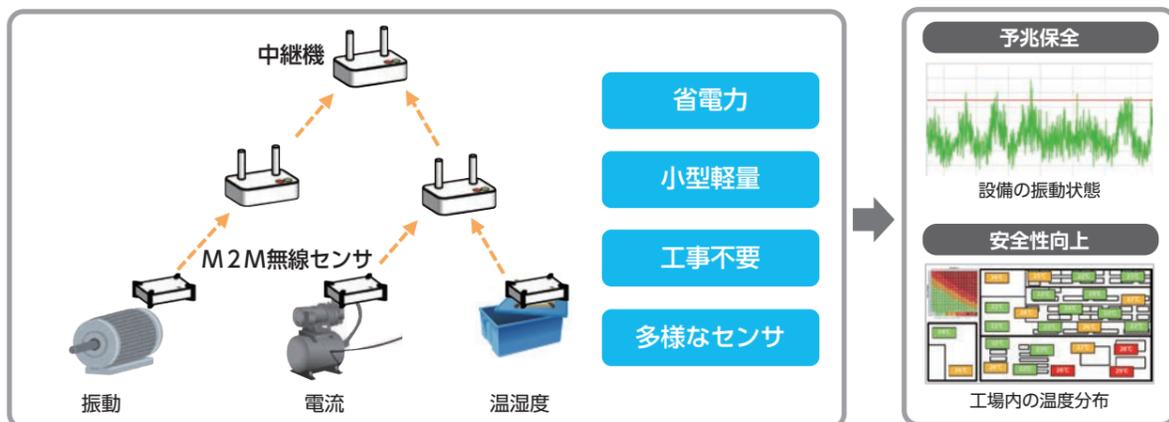
当社グループの製造現場と連携し、生産現場の主要課題である「生産性向上」、「検査自動化」、「予兆保全」、「安全性向上」をテーマに、各種センシング、無線通信、AI/データ分析などのIoT/AI技術を使ったモノづくり支援を推進しています。

推進にあたり、当センターでは、生産技術部・情報システム部と三位一体となり、IoT/AI基盤のシステム開発と人材育成を行っています。



M2M無線センサ

無線通信・電池駆動のため、手軽に設備データなどを収集可能です。また、集めたデータを見える化し、様々な改善に活用することができます。



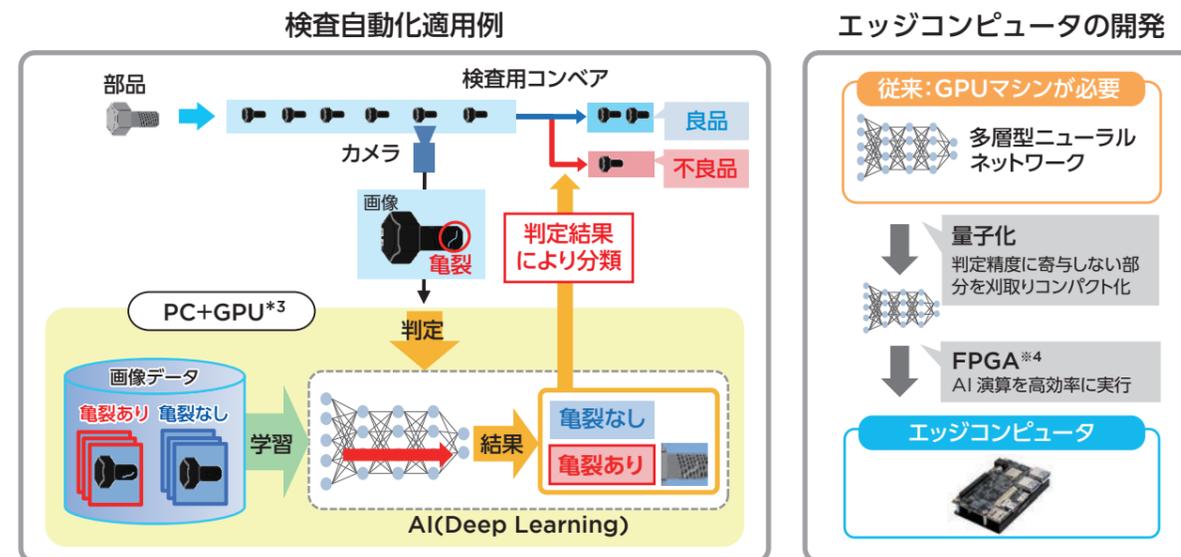
映像分析ツール

古い設備は、データ収集に設備改造が必要であったり、また、人の動きなどの作業者の情報は、データ収集自体が難しいといった課題があります。映像分析ツールでは、稼働率向上を図るため、AI映像分析技術を使いカメラ映像から稼働情報や停止要因を抽出し、見える化します。例えば、段取り作業の時間計測を自動化し、作業時間の超過やばらつきを検出を行ったり、それらの映像を振り返って、発生原因を確認することができます。



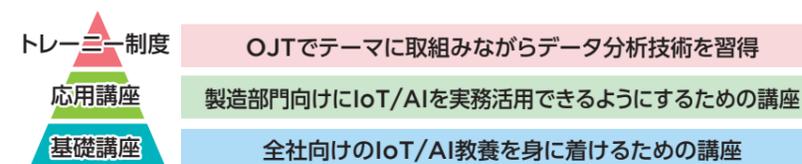
AI 検査自動化

多くの検査工程では目視検査を行う人材の確保・育成が課題となっており、AI技術(Deep Learning^{*2})を活用した検査自動化に取り組んでいます。さらに、自動検査システムの低コスト化・小型化に向け、エッジコンピュータの開発を行っています。



*2 Deep Learning:人間の脳の構造を模倣した多層型ニューラルネットワークを使って学習するAI技術
*3 GPU(Graphics Processing Unit):画像処理に特化した演算装置 *4 FPGA(Field Programmable Gate Array):書き換え可能な論理回路

IoT/AI 人材育成



当社グループの各事業部門が主体的にIoT/AI技術活用を進められるように、3段階の研修メニューを用意し、全社的なIoT/AI人材の育成を推進しています。

大阪、伊丹、横浜の3ヶ所に活動拠点を置き、外部の大型先端研究施設(九州シンクロトロン光研究センターなど)も活用しながら、高度な分析/解析技術とCAE(Computer Aided Engineering)で、住友電工グループの「モノづくり」、新製品開発/新事業開拓、技術基盤を支えています。

戦略的なCAEインフラ整備

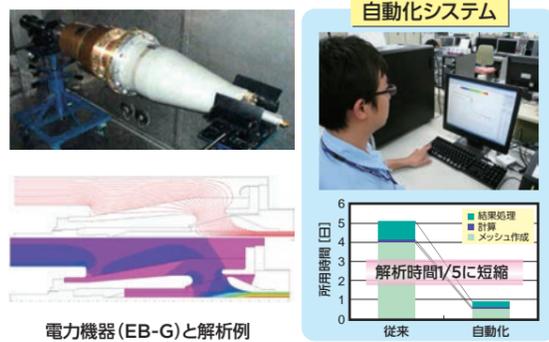


CAEの活用は、単に製品開発の効率化にとどまらず、市場における競争力強化のためのキーテクノロジーのひとつと位置付け、住友電工グループのCAEコア機能を強化するためのインフラ整備に取り組んでいます。

*Lenovo, NeXtScale System は、Lenovo 及びその子会社、関連会社の商標または登録商標です。
*Intel, Xeon は、Intel Corporation の商標または登録商標です。

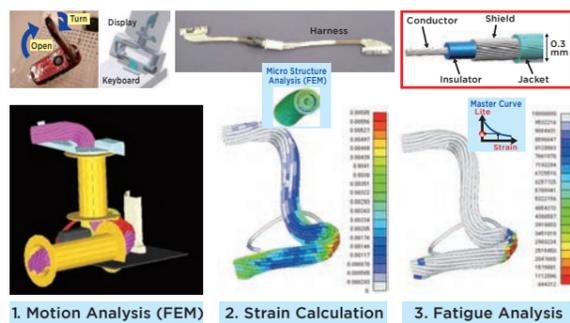


CAE解析技術の普及促進



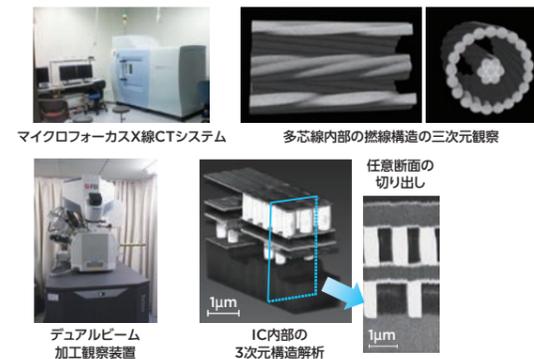
製品設計に有用なCAE解析技術の開発と普及を推進しています。その一環として、設計者への教育や、簡易解析システム、自動解析システムの開発など、ニーズに応じた方法で解析技術の設計部門への移管を進めています。

電線の寿命予測技術



携帯電話のヒンジ部、自動車のドア、ロボットアーム等、可動部に配線される電線ケーブルの捻曲による断線寿命を、計算機シミュレーションで予測する技術を開発しています。

三次元構造可視化技術



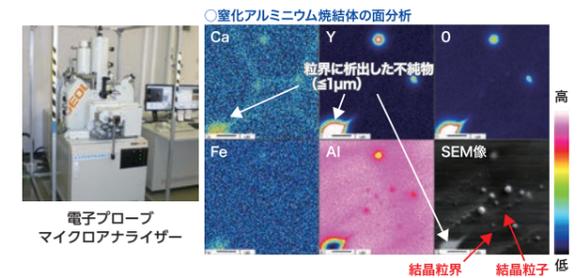
コンポジット材料や部品、製品の三次元構造可視化技術を開発し、

- ・内部構造をみる
- ・特定の狙った位置をみる
- ・あるがまをみる

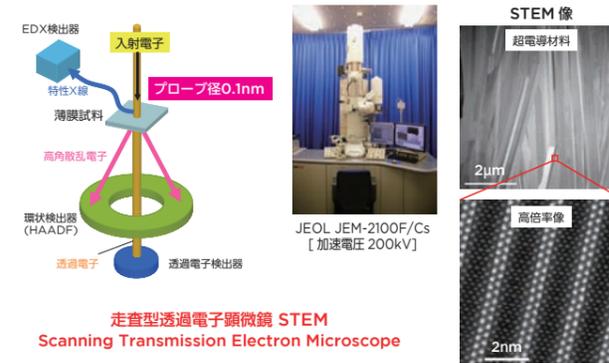
ことにより、品質向上、問題解決へとつなげています。

微小領域組成分布可視化技術

電子プローブマイクロアナライザーを用いて、機能材料、機能部品の特性を決定づける微量ドーパントの分布状態を、高い空間分解能で可視化する技術を開発しています。



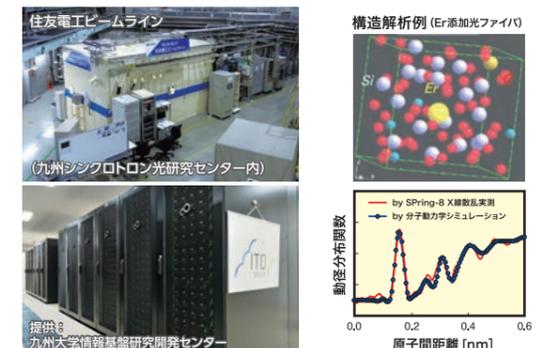
ナノレベル構造解析



透過電子顕微鏡、結晶構造解析を中心とした分析技術の確立と応用展開を目指した、ナノレベル構造解析技術開発に取り組んでいます。これらの技術を活用し、各種材料・デバイスの高品質化、高機能化を支援しています。

放射光分析・第一原理計算等を活用した原子レベル解析

放射光や中性子を利用し、材料の原子レベルでの構造分析や反応その場解析などの技術を開発しています。なお、放射光分析では当社グループの専用ビームラインも活用しています。また、第一原理計算などのシミュレーションと組み合わせ、特性発現機構解明と新材料探索を目指しています。



アドバンストマテリアル研究所

当社独自の超高压技術、粉末冶金技術、高精度計算技術等を駆使したプロセス革新により金属材料、無機材料分野でオンリーワンの新材料創製を実現しています。材料の特性を活かした超硬工具、ダイヤモンド、セラミックス、鉄系焼結部品、特殊鋼線等に関する高機能部材を開発することで、産業素材事業分野を中心に当社の広範な事業の発展に貢献しています。

粉末冶金技術

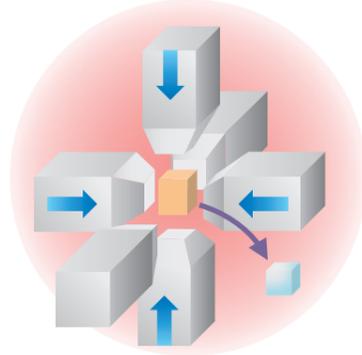
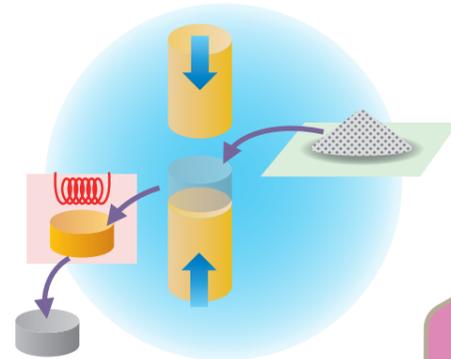
粉末冶金技術では、切削工具に用いる超硬合金、サーメットや、自動車用構造部品に用いる鉄合金、アルミ合金の焼結部品を開発してきました。最近ではモータやセンサ等の高性能化に貢献する磁性材(磁心、磁石)とその製品開発を行っています。



圧粉磁心



焼結ギア



粉末冶金技術

薄膜技術

プロセス革新

加工技術

超高压技術

高精度計算技術

伸線技術

超高压技術

超高压技術では、焼結ダイヤモンドや焼結CBN、高压合成単結晶ダイヤモンドを開発してきました。最近では、ナノサイズの微細構造を持ち天然ダイヤを凌駕する硬度のナノ多結晶ダイヤモンド*とその製品開発を行っています。

*日刊工業十大新製品賞受賞(2013)
大河内記念賞受賞(2014)



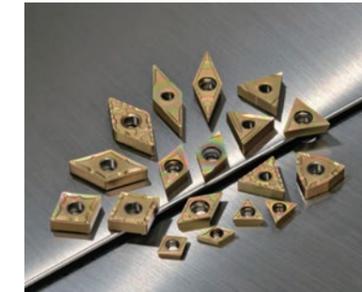
ナノ多結晶ダイヤモンド



高压合成 単結晶ダイヤモンド

薄膜技術

薄膜技術においては、高硬度、高密度のセラミック膜を切削工具に被覆するための研究を進めています。



PVDコーティッドチップ



チップによる旋削加工

加工技術

加工技術では、切削加工のモニタリング技術や、新しい造形技術の開発により、新たな付加価値をもった最先端の切削工具の提供を目指しています。



高能率ミリング加工

伸線技術

伸線技術では、熱処理やめっき技術を併用し、高性能ばね用鋼線やタイヤ用高強度スチールコードの開発を行っています。



弁バネ用オイルテンパー線



スチールコード

金属無機材料、高分子材料、微細回路形成をコア技術として、当社グループの幅広い事業分野の新製品・新技術の開発に貢献しています。

金属無機材料技術

高分子材料技術

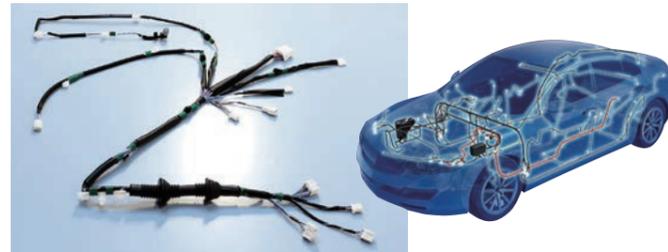
微細回路形成技術

金属無機材料技術

連続鋳造や塑性加工といった技術を活かし、自動車用配線材料の軽量化を目的として、アルミニウム合金線やそれを用いたワイヤハーネスの開発をグループ企業とも協力して進めています。

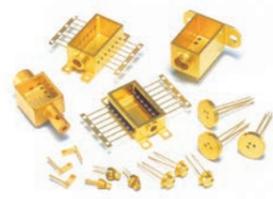


アルミニウム合金線

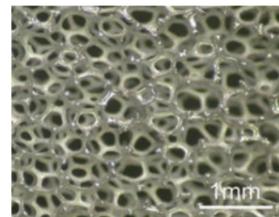


アルミハーネス

金めっき等から出発しためっき技術は、セルメット®のような当社独自の新素材を生み出して来ました。

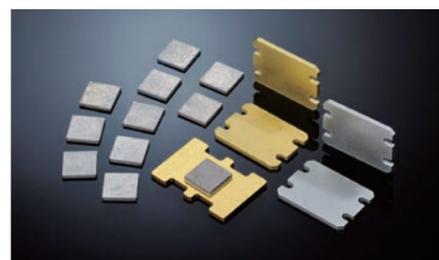


金めっき製品



耐熱・耐食セルメット

異種材料の複合化技術を用いて、熱伝導率、熱膨張率など複数の特性を同時に最適化した材料を開発しています。



AgDiaヒートシンク

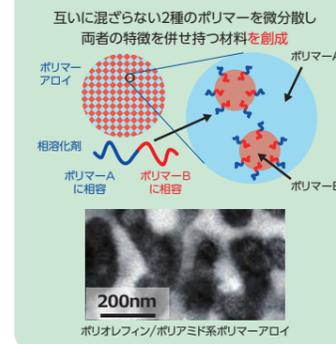
高分子材料技術

高分子合成や樹脂配合の技術を活かし、環境エネルギー、エレクトロニクス、自動車の各分野の電線・ケーブルや環境対応車用モーター巻線などの多くの応用製品を生み出しています。

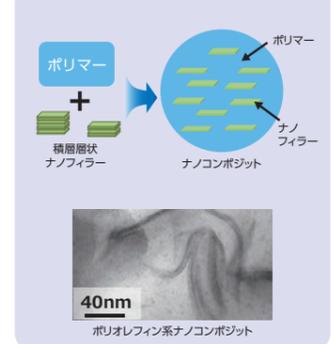
更に、ナノサイズの世界構造制御(ポリマーアロイ、ナノコンポジット)により、新機能・高性能高分子材料の開発に取り組んでいます。

高分子合成・樹脂配合技術

ポリマーアロイ



ナノコンポジット



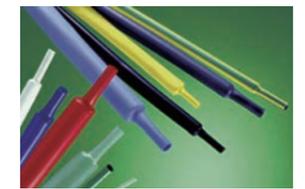
環境対応車用モーター巻線



超高压直流架橋ポリエチレン電力ケーブル



電動パーキングブレーキ複合ケーブル

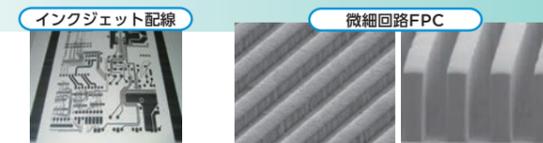
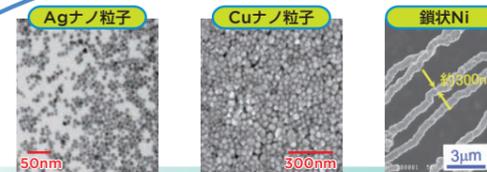


熱収縮チューブ

微細回路形成技術

回路の高密度・微細化に対応する技術として、各種の金属材料のナノ粒子化と、そのインク・ペースト化の開発を進めるとともに、エレクトロニクス製品への応用展開を進めています。

金属ナノ粒子合成・応用技術



ペースト配合・印刷技術

回路形成技術

携帯機器・スマートフォン



ディスプレイ・タッチパネル



ウェアラブル端末



アクチュエーターコイル



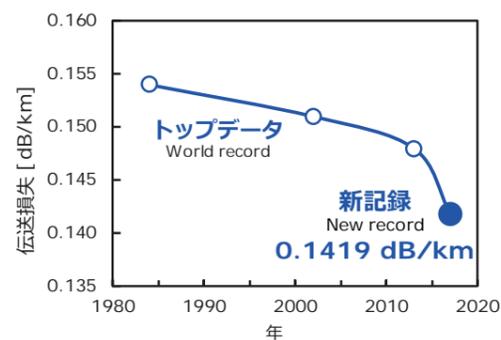
ブロードバンド通信ネットワークの基盤となる光ファイバ技術のたゆまぬ革新を推し進めるとともに、データセンタや民生分野への展開を促進し、スマート社会の発展に貢献します。さらに光技術の新領域展開にも取り組んでいます。

光ファイバの開発



Z-PLUS Fiber® 150

純国産の光ファイバ製造技術である気相軸付け法(VAD法)の開発を1970年代前半より進めており、光ファイバの量産技術として事業展開されています。光通信研究所では、光ファイバの機能向上に向けた構造設計と生産技術の革新を推し進めています。

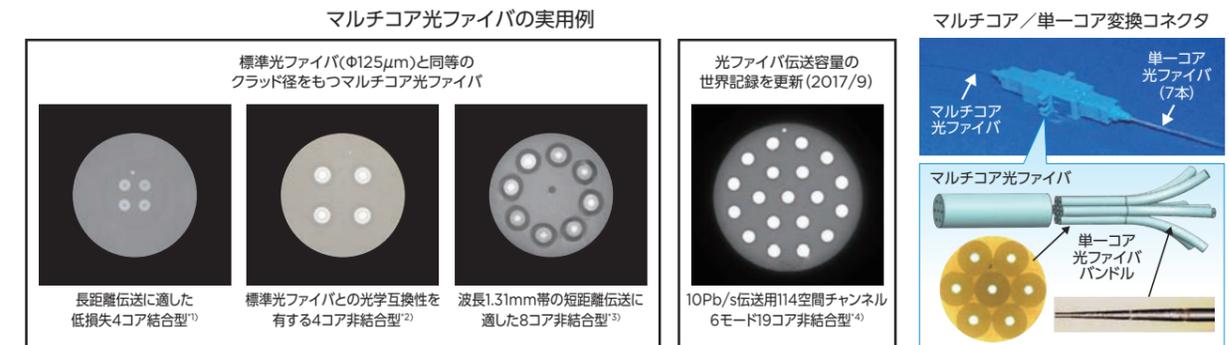


極低損失純石英コア光ファイバ

当社が開発した世界で最も低い伝送損失を誇る極低損失純石英コア光ファイバは、高速大容量デジタルコヒーレント通信システムに最適です。特に、太平洋横断級の巨大な海底光ケーブルシステムで広く採用されています。2017年3月には、ガラスおよび被覆技術を更に向上させ、伝送損失0.1419 dB/km(波長1560 nm)を達成し、光ファイバ伝送損失の世界記録を更新致しました。

次世代光ファイバ・接続技術

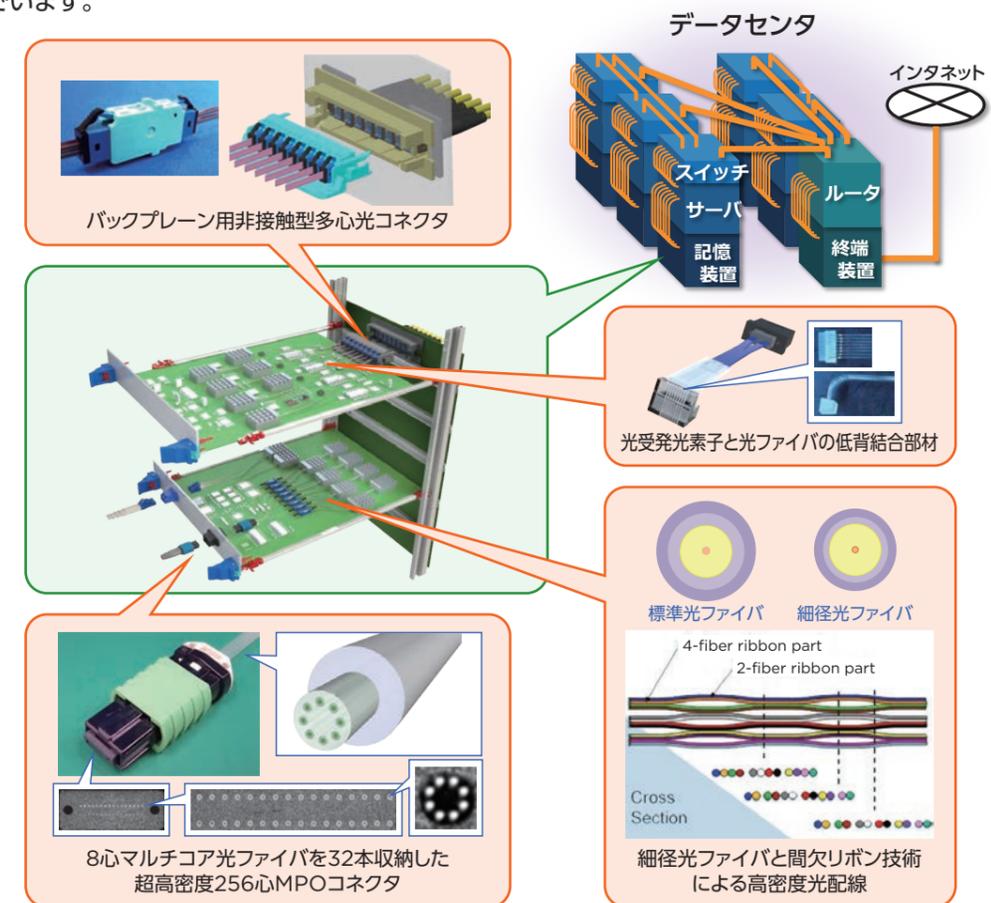
標準光ファイバの限界を突破し、ファイバ1本でペタビット級光通信を実現する革新的なマルチコア光ファイバ(MCF)及びその接続技術の研究開発を行っています。



- 1) <http://www.sei.co.jp/company/press/2016/03/prs023.html>
- 2) <http://www.ntt.co.jp/news2017/1708/170808b.html>
- 3) <http://www.sei.co.jp/company/press/2015/03/prs022.html>
- 4) <http://www.kddi-research.jp/newsrelease/2017/092201.html>
- <http://www.sei.co.jp/company/press/2017/prs083.pdf>
- <http://www.sei.co.jp/company/press/2017/prs097.pdf>

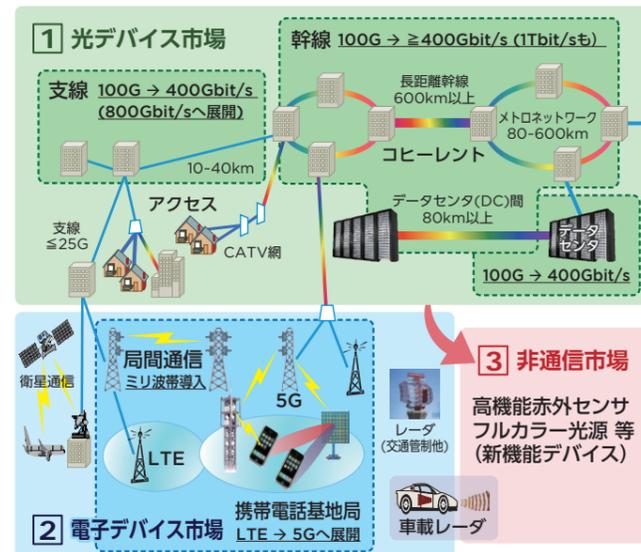
データセンタ・民生機器向け大容量インタコネクション技術

急速に拡大するデータセンタの低消費電力化、配線高速化に貢献するために、メタルと光の配線技術を駆使した大容量インタコネクション製品群を開発しています。高速化を求められている民生機器用情報配線の開発にも取り組んでいます。



化合物半導体結晶、エピ／プロセス、光・電子部品の精密実装、光トランシーバ設計などの技術を用いて、先進的な化合物半導体材料や、光と無線の2大情報通信市場に向けた製品を開発しています。

さらに、これまで培ってきた要素技術を応用し、非通信市場への展開も目指しています。



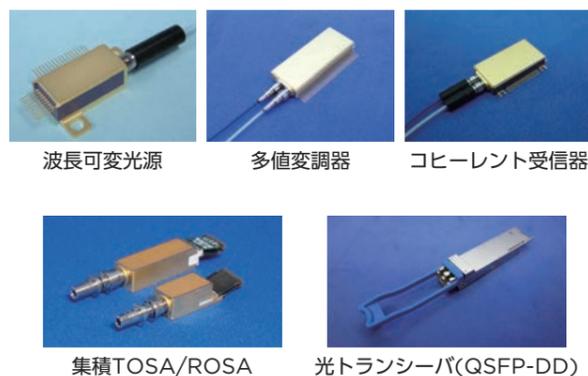
当社化合物半導体とその応用分野

材料	発光デバイス	電子デバイス
GaAs	赤色レーザー 可視・赤外LED (DVD、パソコン、自動車、屋外表示) 赤外レーザー・受光素子 (光通信)	高周波IC パワーアンプ (携帯電話、無線通信基地局、衛星通信)
InP	青紫レーザー 青色・白色LED (Blu-ray、液晶バックライト、屋外表示、照明)	高周波パワーデバイス 大電力低損失デバイス (無線基地局、電力制御機器、電気自動車)
GaN	紫外発光素子 (殺菌、洗浄、加工)	次世代パワーデバイス (高周波・電力機器)

化合物半導体は、シリコン半導体では実現できない各種応用領域にて広く利用されています。当社はこの分野のパイオニアとして各種の材料を開発しており、より高品質、大口径の結晶成長技術や、新規デバイスの創出に向けた新材料の開発を推進しています。

*Blu-ray は、Blu-ray Disc Association の商標または登録商標です。

光通信デバイス



光通信システムの中で、電気信号⇄光信号の変換を行うデバイスの開発を行っています。

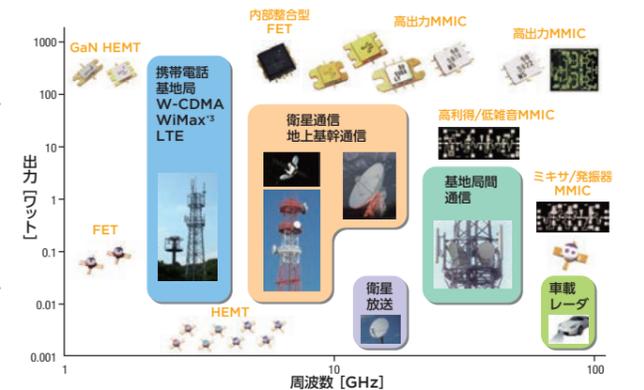
幹線系では、10Tbit/s級の超大容量伝送実現のためにデジタルコヒーレント伝送技術が適用されており、重要な構成要素となる、高出力狭線幅波長可変光源、多値変調器、コヒーレント受信器を当社独自の化合物半導体技術を用いて開発しています。

支線系やデータセンタ向けでは、光サブアセンブリ(OXA)や大容量光トランシーバの製品開発を進めています。光伝送容量の急速な拡大に対応すべく、小型低消費電力化や高速化に取り組んでいます。

無線通信デバイス

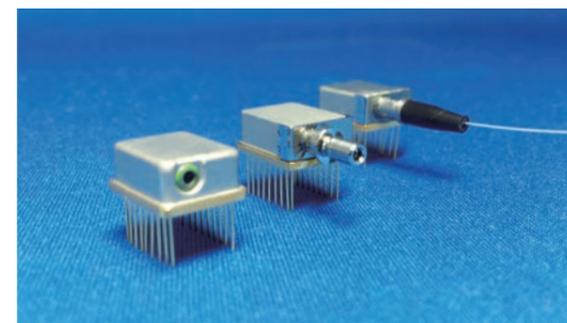
当社は、他社に先駆けて砒化ガリウム(GaAs)を用いたHEMT*1を開発し、無線通信の発展に寄与してきました。その技術を、窒化ガリウム(GaN)に適用することにより、広帯域携帯無線(LTE)基地局の小型化、高効率化に大きく貢献して来ています。

さらに、第五世代無線通信(5G)の導入に向け、更なる高効率化と高周波化を目指しています。高周波・高出力特性を活かし、基地局間および衛星無線の通信大容量化や、様々なレーダの固体化にも展開しています。これらHEMTを集積化したMMIC*2の技術はミリ波帯の車載レーダにも採用されています。



*1 High Electron Mobility Transistor (高電子移動度トランジスタ) *2 Monolithic Microwave Integrated Circuit (マイクロ波モノリシック集積回路)
 *3 WiMax は、WiMAX Forum の商標または登録商標です。

超小型 RGB レーザモジュール



当社がこれまで培ってきた可視レーザ技術と通信用精密実装技術を融合し、新たに光の3原色である赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)の半導体レーザと光学部品、熱電クーラーを集積させた、超小型RGBレーザモジュールを開発しています。

異なる基板材料を持つ3原色の半導体レーザを集積化し、熱電クーラーで効率的に温度制御することで、広い温度範囲での安定動作が可能です。

また当社独自の3原色のビーム合わせ技術により、高解像度の映像を実現しています。

今後、ヘッドアップディスプレイ、プロジェクタ、ポインタ、イルミネーション、産業機器の分野に広く使用されることが期待されています。

赤外線センシングデバイス



光通信用受光素子の要素技術を応用して、量子井戸型の赤外線イメージセンサの開発を行っています。従来のセンサと比較して高感度で、微量分析や微小な温度差を画像で検知する診断システムに適しています。

また、高感度なガス検知への応用を目指して中赤外量子カスケードレーザの開発も行っています。

パワーデバイス開発部

省エネルギーをさらに進化させる次世代のパワーデバイス材料として期待されている炭化ケイ素 (SiC) において、高品質、低コスト成長技術 (MPZ^{®1}) を用いた結晶、エピタキシャル基板の開発を推進しています。さらに低損失、高耐圧を両立する独自構造のトランジスタ、モジュールの開発にも取り組み、社内連携によるシステムへの展開も視野にその実用化を目指しています。

*1 MPZ: Multi-Parameter and Zone controlled SiC Growth Technology



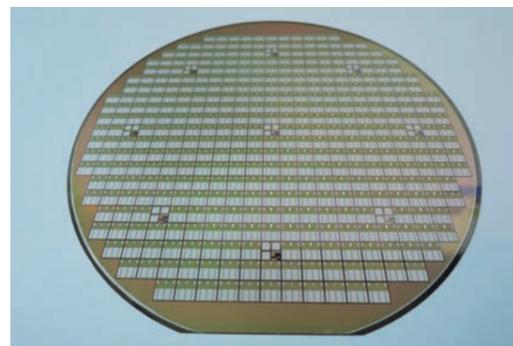
高品質 SiC 結晶・エピタキシャル基板

成長時の温度、反応プロセスを緻密に制御するMPZ[®]により、高品質、大口径の結晶開発に取り組んでいます。

結晶から切り出し、鏡面加工した基板の上に、化学気相成長 (CVD) 法により、単結晶 (エピタキシャル) 層を形成します。

MPZ[®]を用いることで、世界トップレベルの高均一、かつ面内99%以上の領域で欠陥のないエピタキシャル基板を実現しています。製品名「EpiEra[®]」として販売を開始、電子デバイス産業新聞主催の半導体・オブ・ザ・イヤー2018でグランプリ (電子材料部門) を受賞しました。

エピタキシャル基板の上に、イオン注入、絶縁膜形成、電極形成などの半導体プロセスを施し、トランジスタを作製します。



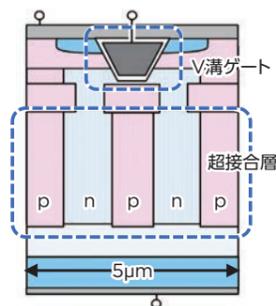
SiCエピ基板の上に作製されたトランジスタ

高効率 SiC パワートランジスタ

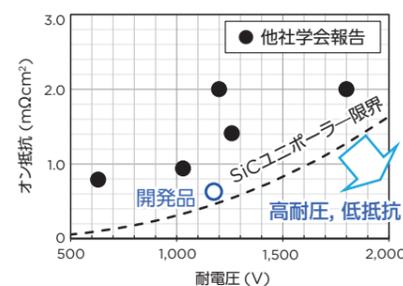
安定性に優れた特殊な結晶面を活用した独自構造をもつ「V溝型金属-酸化膜-半導体構造トランジスタ (V-MOSFET²)」を開発し、高効率・高耐圧・高安定性を実現しています。1チップで200A級の大電流特性を実現し、電気自動車/ハイブリッド電気自動車 (EV/HEV) などへの適用による効率向上が期待されています。

さらに、国立研究開発法人 産業技術総合研究所との共同研究で、SiCの理論限界に近い世界最小の低オン抵抗を有する次世代VMOSFETの開発を進めています。

*2 VMOSFET: V-groove Trench Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

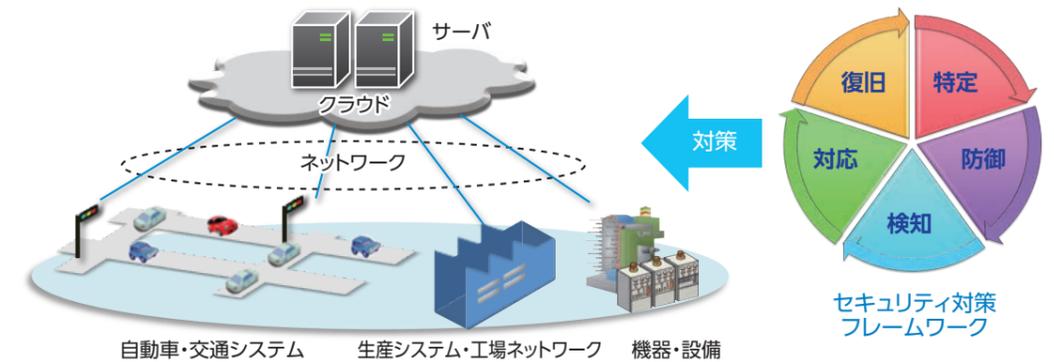


次世代 VMOSFET の構造とオン抵抗

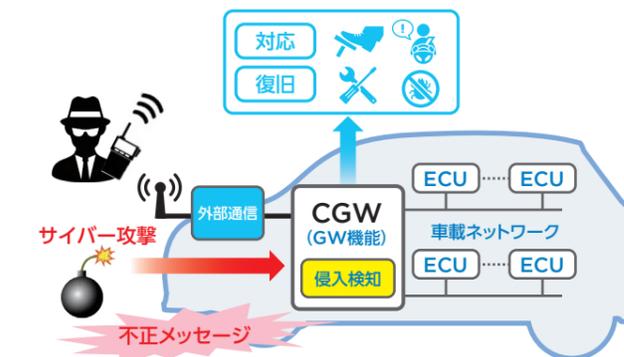


サイバーセキュリティ研究開発室

当社の各事業領域 (情報通信、自動車、環境エネルギー、エレクトロニクス、産業素材) においてネットワークに接続される電子製品群を対象にサイバー攻撃への対策技術の研究開発を行っています。また、産業技術総合研究所との間で設立した「住友電工-産総研サイバーセキュリティ連携研究室」とサイバーセキュリティにおける先進技術の研究活動を実施しています。



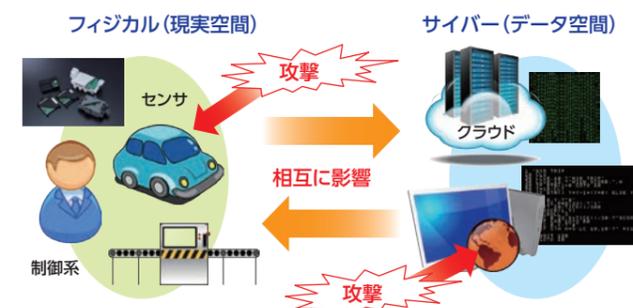
車載セキュリティ



自動運転技術やコネクテッドカーの登場により、急速に高まっている自動車のサイバーセキュリティ対策技術の研究開発に取り組んでいます。分析技術や機械学習を応用した車載ネットワークへの未知のサイバー攻撃検知技術の開発、最新の暗号技術の車載機器、通信への適用等、セキュリティ強化に向けた研究を進めています。

*ECU: Electronic Control Unit
*TCU: Telematics Communication Unit

サイバーフィジカルセキュリティ



IoTの進展によるフィジカルとサイバーの密接な繋がり拡大にともない、サイバー空間から現実空間への攻撃、現実空間からサイバー空間への攻撃等、従来と異なる脅威に対する対策が必要となってきています。

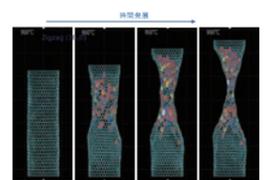
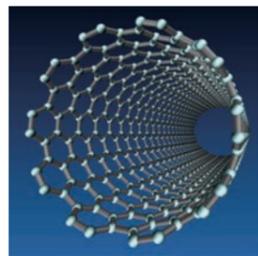
当研究開発室では、ハードウェアとソフトウェアの両面から対策技術の研究開発に取り組んでいます。

新領域技術研究所

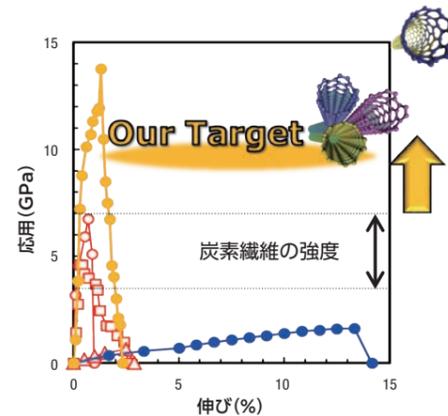
当社事業に影響を及ぼす技術革新・社会革新に着目し、将来必要となってくる新技術の開発に取り組んでいます。

次世代カーボン線材

カーボンナノチューブ(CNT)の高配向線材化により、破断強度10GPa(既存の炭素繊維の約2倍)以上の超高強度線の合成に成功。宇宙エレベータはじめ、人類未踏領域への挑戦に貢献します。

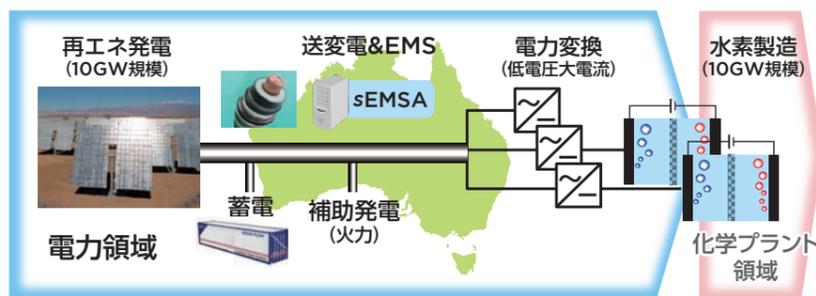


CNT変形挙動シミュレーション



水素社会&水素製造

温室効果ガスの発生しないクリーンエネルギーである水素を安価で大量に製造するための要素技術を開発しています。太陽光の豊富なオーストラリアで実証システムを構築中です。



実証システム(建築中)

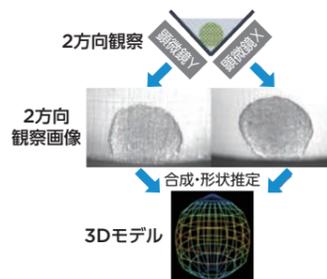
CORE-DX(デジタル変革への対応)

世の中の最新のDX・AI関連技術を調査・分析し、当社事業部門の新製品/新ビジネスの創出に繋がります。



細胞検査技術

将来の再生医療に備え、細胞塊の立体構造を観察できる細胞顕微鏡や観察技術の研究を進めています。



電力ケーブル開発推進室

電力ケーブル開発推進室は、材料技術、分析・解析技術、センシング・伝送技術を結集し、電力インフラ事業に貢献する研究開発を行っています。

電力ケーブル

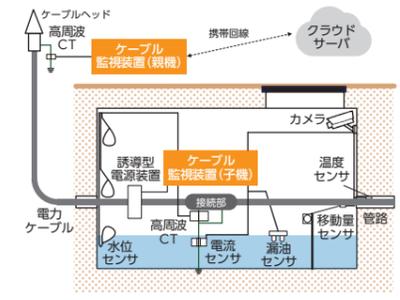
超高压直流ケーブル用のナノコンポジット絶縁材料、洋上風力等再生可能エネルギー送電海底ケーブル用の耐水トリー性絶縁材料など世界トップレベルの絶縁材料を開発しています。また、分析・解析技術を駆使して材料に最適化した生産技術開発も行い、次世代を担う高品質な電力ケーブルの製品化を加速しています。



直流400kV電力ケーブル

電力線監視システム

地中送電線設備の運用、保守の高度化に役立つ遠隔監視システムの開発を目指しています。各種センサによる設備情報を電力線通信技術(PLC)を用いてモニタリングし、IoTを用いたデジタル化、AIや機械学習などを活用したデジタルトランスフォーメーション(DX)の導入を進めて、送電容量を動的に監視するダイナミックレーティングシステムや高感度部分放電検出センサによる予防保全システムの製品化を進めます。



管路布設ケーブル及びマンホール設備遠隔監視システム

研究企画業務部

当社の経営の方向性を定めた中期経営計画(22VISION)を実行するために、研究開発部門における計画の取りまとめや実績管理・調整を行っています。

また、技術・事業領域を発展させていくために、研究テーマの創出や開発成果の事業化を支援するとともに、グループ企業との連携、大学や研究機関との共同研究、国家プロジェクトの活用、他社との協業を推進しています。米国及び欧州については、現地の拠点を通じて最新情報の収集や開発プロジェクトへの参入を進めています。

さらには研究部門を担う人材とそのネットワークを育てるため、各種の研修を企画・実施しています。